PTO/SB/21 (09-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE work Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a c ollection of information unless it displays a valid OMB control number. **Application Number** 10/711,617 TRANSMITTAL Filing Date 09/29/2004 First Named Inventor **FORM** Pao-Yun Tang Art Unit Examiner Name (to be used for all correspondence after initial filing) Attorney Docket Number HANP0006USA Total Number of Pages in This Submission **ENCLOSURES** (Check all that apply) After Allowance Communication to TC ~ Fee Transmittal Form Drawing(s) Appeal Communication to Board Licensing-related Papers Fee Attached of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC Petition Amendment/Reply (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Petition to Convert to a Proprietary Information After Final Provisional Application Power of Attorney, Revocation Status Letter Affidavits/declaration(s) Change of Correspondence Address Other Enclosure(s) (please Identify Terminal Disclaimer **Extension of Time Request** below): Request for Refund **Express Abandonment Request** CD, Number of CD(s) Information Disclosure Statement Landscape Table on CD Certified Copy of Priority Remarks Document(s) Reply to Missing Parts/ Incomplete Application Reply to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53 SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT Firm Name North America Intellectual Property Corp. Signature Printed name Winston Hsu Date Reg. No. 11/22/2004 41.526 **CERTIFICATE OF TRANSMISSION/MAILING**

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below: Signature Typed or printed name

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

11/22/2004

Date

PTO/SB/17 (10-04)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

CEETDANGMITTAL			(Complete if Known				
FEE TRANSMITTA	┕║	Applic	oplication Number 10/711,617					
for FY 2005		Filing	Filing Date 09/29/2004			004		
		First N	First Named Inventor Pao-Yun Tang			n Tang		
Effective 10/01/2004. Patent fees are subject to annual revision.		Examiner Name						
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27		Art Unit						
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00		Attorn	ey Docl	ket No.	HANP0	006USA		
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)					CALCULAT	TION (continued)		
Check Credit card Money Other None	3. ADDITIONAL FEES							
Deposit Account:	<u>Large</u>	Entity	Small E	ntity				
Deposit 50.0405	Fee Code		Fee F Code (ee \$)	Fee [Description	Fee Paid	
Account Number	1051		2051	65 Su	urcharge - late	filing fee or oath		
Deposit Account North America Intellectual Property Corp.	1052	2 50	2052		urcharge - late	provisional filing fee or		
Name The Director is authorized to: (check all that apply)	1053	3 130	1053		on-English spe	ecification		
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812	2 2,520	1812 2,	520 Fo	or filing a reque	est for ex parte reexamination		
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804	920*	1804		equesting publication	lication of SIR prior to		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805	5 1,840*	1805 1,		equesting pub xaminer actior	lication of SIR after		
FEE CALCULATION	1251	1 110	2251	55 E	xtension for re	ply within first month	<u> </u>	
1. BASIC FILING FEE	1252	2 430	2252	215 E	xtension for re	eply within second month		
Large Entity Small Entity	1253	3 980	2253	490 E	xtension for re	eply within third month		
Fee Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid Code (\$)	1254	1,530	2254	765 E	xtension for re	ply within fourth month		
1001 790 2001 395 Utility filing fee	1255	5 2,080	2255	1,040 E	xtension for re	eply within fifth month		
1002 350 2002 175 Design filing fee	1401		2401		lotice of Appea			
1003 550 2003 275 Plant filing fee	1402		2402		-	support of an appeal		
1004 790 2004 395 Reissue filing fee	1403	3 300 1 1,510	2403		equest for ora	_	 	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1452	-	2452			ute a public use proceeding e - unavoidable		
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00		3 1,330	2453			e - unintentional		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE		1 1,370	2501		Itility issue fee			
Fee from Ext <u>ra Claim</u> s <u>below</u> <u>Fee Paid</u>	1502		2502		esign issue fe	,		
Total Claims20** = X =	1503	660	2503	330 P	Plant issue fee			
Claims X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1460	130	1460	130 P	etitions to the	Commissioner		
	1807	7 50	1807	50 P	Processing fee	under 37 CFR 1.17(q)		
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806			nformation Disclosure Stmt		
Code (\$)	8021	1 40	8021	40 Re	ecording each roperty (times	patent assignment per number of properties)	<u> </u>	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 88 2201 44 Independent claims in excess of 3	1809	790	2809	395 Fi		sion after final rejection		
1203 300 2203 150 Multiple dependent claim, if not paid	1810	790	2810	395 F	or each addition	onal invention to be		
1204 88 2204 44 ** Reissue independent claims over original patent	180	1 790	2801		xamined (37 C	CFR 1.129(b)) ontinued Examination (RCE)		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20	1802		1802	900 F	Request for ex	pedited examination		
and over original patent	Othe	er fee (sp	ecify)	0	of a design app	DIICATION		
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00		duced by		ing Fee	Paid c	SUBTOTAL (3) (\$) 0.00		
"or number previously paid, if greater; For Reissues, see above			-					
SUBMITTED BY Name (PrintTrans) Wineston Hou	T	Registra	tion No.	144.50		(Complete (if applicable))		
Name (Print/Type) Winston Hsu		(Attorney/		41,52	. 6	Telephone 302-729-1562		

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



PTO/SB/02B (09-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Panetwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number

DECLARATION – Supplemental Priority Data Sheet

Foreign applications:					
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy YES	y Attached? NO
093116427	Taiwan R.O.C.	6/8/2004		V	
		•			
·					
		,			

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



ए। ए ए ए ए ए

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPÉRTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2004 年) 06 月 08 日

Application Date

인도 인터 인도 인도 인도 한도 한다

52

申 請 案 號: 093116427

BEST AVAILABLE COPY

) Application No.

申 請 人: 瀚宇彩晶股份有限公司

Applicant(s)

局 長 Director General

蔡練:

發文日期: 西元 ______ 月

Issue Date

發文字號: 09320703120 Serial No.

जिए जिल्ले जिल्ल

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字,請勿任意更動,※記號部分請勿填寫)

※申請案號:

※申請日期:

※IPC 分類:

壹、發明名稱:(中文/英文)

液晶顯示模組 /

LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE

貳、申請人:(共1人)

姓名或名稱:(中文/英文)

瀚宇彩晶股份有限公司 / HANNSTAR DISPLAY CORP.

代表人:(中文/英文)

焦佑麒 / CHIAO, YU-CHI

住居所或營業所地址:(中文/英文)

桃園縣楊梅鎮高獅路五八 0 號 / No. 580, Kaoshi Road, Yangmei, Taoyuan, Taiwan, R.O.C.

國 籍:(中文/英文) 中華民國 / TWN

參、發明人:(共3人)

姓 名:(中文/英文)

- 1. 湯寶雲 / TANG, PAO-YUN
- 2. 何樹林 / HO, SHU-LIN
- 3. 楊界雄 / YANG, KEI-HSIUNG

住居所地址:(中文/英文)

- 1. 320 桃園縣中壢市普慶里五鄰普仁六六之九三號 / Puren 66-93, Puching Li, Chongli, Tao-Yuan Hsien 320, Taiwan, R.O.C.
- 2. 270 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里南寧路二十一號 / No. 21, Nanning Rd., Nanning Li, Su-ao, I-Lan Hsien 270, Taiwan, R.O.C.
- 3. 300 新竹市光復路一段八十九巷一二三之五號 / No. 123-5, Lane 89, Sec. 1, Guanfu Rd., Hsin-Chu City 300, Taiwan, R.O.C.

- 國 籍:(中文/英文)
 - 1. 中華民國 / TWN
 - 2. 中華民國 / TWN
 - 3. 中華民國 / TWN

肆	•	聲	明	事	項	:
---	---	---	---	---	---	---

■ 本案係符合專利法第二十條第一項 第一款但書或 第二款但書規定之期
間,其日期為: 年 月 日。
◎本案申請前已向下列國家(地區)申請專利 □ 主張國際優先權:
【格式請依:受理國家(地區);申請日;申請案號數 順序註記】
1.
2.
3.
4.
5.
□ 主張國內優先權(專利法第二十五條之一):
【格式請依:申請日;申請案號數 順序註記】
1
2.
主張專利法第二十六條微生物:
圆內微生物 【格式請依:寄存機構;日期;號碼 順序註記】
•.
□ 國外微生物 【格式請依:寄存國名;機構;日期;號碼 順序註記】
前羽访佰甘街书县林催復,不須宏方。

伍、中文發明摘要:

一種使用覆晶構裝方式製造的液晶顯示模組,其具有至少一玻璃基板,且玻璃基板上具有一顯示區,一周邊區,複數條掃描線以及複數條資料線分別沿水平方向及垂直方向設置於顯示區上。此外,液晶顯示模組還具有至少一閘極驅動晶片,貼合於周邊區上,閘極驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至掃描線,且閘極驅動晶片之厚度小於 0.3 公釐。薄膜電晶體液晶顯示模組還具有至少一資料驅動晶片,貼合於周邊區上,資料驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至資料線,且資料驅動晶片之厚度小於 0.3 公釐。

陸、英文發明摘要:

A liquid crystal display module manufactured by a chip-on-glass structure has at least one glass substrate. The glass substrate has a display area and a peripheral area, and a plurality of scan lines and data lines form the display area along the horizontal and vertical directions separately. The liquid crystal display module also has at least one gate driver chip attached on the peripheral area. The gate driver chip transmits signals to the scan lines with a plurality of output terminals, and the thickness of the gate driver chip is less than 0.3mm. The liquid crystal display module further has at least one data driver chip attached on the peripheral area. The data driver chip transmits signals to the data lines with a plurality of output terminals, and the thickness of the data driver chip is less than 0.3mm.

柒、指定代表圖:

- (一)本案指定代表圖為:第(六)圖。
- (二)本代表圖之元件代表符號簡單說明:

202、204 玻璃基板

208 閘極驅動晶片

210 異方性導電膜

212 軟性電路板

捌、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學式:

無

玖、發明說明:

【發明所屬之技術領域】

本發明提供一種液晶顯示模組,尤指一種使用覆晶構裝方式製造之液晶顯示模組。

【先前技術】

覆晶玻璃(chip on glass, COG)構裝技術,是一種使用高接腳數(high pin count)以及超細節距(fine pitch)來構成平面顯示器的模組構裝技術,其中閘極驅動晶片或是資料驅動晶片係以異方性導電膜(anisotropic conductive film, ACF)直接接合於玻璃基板上。此種模組構裝技術在閘極驅動晶片或是資料驅動晶片訊號源與畫素之間,具有最少的接合點,可以有效提高產品的可靠度。

異方性導電膜的厚度選擇與接點的金屬凸塊(gold bump)之高度有關,例如金屬凸塊高度為 15 至 18 微米(μm)時,異方性導電膜的厚度選擇約在 23 至 25 微米。而覆晶構裝時使用的閘極驅動晶片或是資料驅動晶片數目,則是與產品解析度以及驅動晶片之訊號輸出腳位數有關。對 XGA(1024x768)解析度的液晶顯示器而

言,若資料驅動晶片之最大輸出腳位數為384, 閘極驅動晶片之最大輸出腳位數為256, 則進行覆晶構裝時需使用8顆資料驅動晶片以及3顆閘極驅動晶片。

請參考圖一,圖一為習知使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之示意圖。液晶顯示模組 100 包含有二片平行堆疊的玻璃基板 102 及 104,其中玻璃基板 102 係為彩色濾光片基板,而玻璃基板 104 則為薄膜電晶體電路基板。液晶顯示模組 100 可以分為二個區域:顯示區 120 以及周邊區 130,其中在周邊區 130 的玻璃基板 104 上形成有資料驅動晶片 106 以及閘極驅動晶片 108。資料驅動晶片 106 及閘極驅動晶片 108 係藉由異方性導電膜與設置於玻璃基板 104 上的金屬凸塊(未顯示於圖中)接合,接合時異方性導電膜的溫度係在 170 至 190℃左右。

請參考圖二,圖二為習知使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之剖面圖,由圖二中可更詳細了解液晶顯示模組 100 之構造。 閘極驅動晶片 108 藉由異方性導電膜 110 與玻璃基板 104 接合, 而且至少有一軟性電路板 112 貼合於周邊區 130,用來傳輸各種控 制訊號。

此種習知覆晶構裝製造技術,會因為資料驅動晶片106、閘極

驅動晶片 108、玻璃基板 104 以及異方性導電膜 110 的熱膨脹係數之差異,使接合點從高溫冷卻至室溫時有殘餘應力產生於玻璃基板 104 表面。如圖三所示,此種殘餘應力會使得玻璃基板 104 翹曲,進而在資料驅動晶片 106 以及閘極驅動晶片 108 接合點附近產生幕狀缺陷(curtain mura)。幕狀缺陷係如圖四所示之情形,在顯示區 120 中靠近資料驅動晶片 106 以及閘極驅動晶片 108 接合點位置,會發生畫面不均勻的現象,此即為玻璃基板 104 翹曲影響液晶之光電效應所造成之缺陷。

【發明內容】

因此本發明之主要目的在於提供一種可改善玻璃基板翹曲情形之液晶顯示模組,以解決習知幕狀缺陷的問題。

根據本發明之申請專利範圍,係揭露一種使用覆晶構裝方式製造的液晶顯示模組。液晶顯示模組具有至少一玻璃基板,玻璃基板上具有一顯示區以及一周邊區,複數條掃描線以及複數條資料線分別沿水平方向及垂直方向形成於顯示區上。此外,液晶顯示模組還具有至少一閘極驅動晶片,貼合於周邊區上,閘極驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至掃描線,且閘極驅動晶片之厚度小於 0.3 公釐。薄膜電晶體液晶顯示模組還具有至少一資料驅動

晶片,貼合於周邊區上,資料驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊 號至資料線,且資料驅動晶片之厚度小於 0.3 公釐。

根據本發明之申請專利範圍,另揭露一種使用覆晶構裝方式製造的液晶顯示模組。液晶顯示模組具有至少一玻璃基板,玻璃基板上具有一顯示區以及一周邊區,複數條掃描線以及複數條資料線分別沿水平方向及垂直方向形成於顯示區上。此外,液晶顯示模組還具有至少一閘極驅動晶片,貼合於周邊區上,閘極驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至掃描線,且閘極驅動晶片具有可撓曲性。薄膜電晶體液晶顯示模組還具有至少一資料驅動晶片,貼合於周邊區上,資料驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至資料線,且資料驅動晶片具有可撓曲性。

【實施方式】

本發明提供一種使用覆晶構裝方式製造之液晶顯示模組,其閘極驅動晶片與資料驅動晶片具有可撓曲的特性。當資料驅動晶片或閘極驅動晶片與玻璃基板的熱膨脹係數不同時,接合點從高溫冷卻至室溫時所產生的殘餘應力可以藉由資料驅動晶片或閘極驅動晶片產生彎曲來消除,減低玻璃基板翹曲的程度。玻璃基板翹曲的程度減低之後,幕狀缺陷的情形也會同時獲得改善。

請參考圖五及圖六,圖五為本發明使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之示意圖,而圖六則為本發明使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之剖面圖。圖五中之液晶顯示模組 200 與圖一中之液晶顯示模組 100 外觀近似,其差別在於液晶顯示模組 200 的開極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 具有可撓曲的特性,至於液晶顯示模組 100 的開極驅動晶片 108 與資料驅動晶片 106 則不具有可撓曲的特性。

如圖五與圖六所示,液晶顯示模組 200 包含有二片平行堆疊的玻璃基板 202 及 204,其中玻璃基板 202 係為彩色濾光片基板,而玻璃基板 204 則為薄膜電晶體電路基板。液晶顯示模組 200 可以分為二個區域:顯示區 220 以及周邊區 230,其中複數條掃描線 214 以及複數條資料線 216 分別沿水平方向及垂直方向設置於顯示區 220 上。周邊區 230 的玻璃基板 204 上則形成有資料驅動晶片 206 以及閘極驅動晶片 208。資料驅動晶片 206 及閘極驅動晶片 208 係藉由異方性導電膜 210 與玻璃基板 204 上的金屬凸塊(未顯示於圖中)接合,而且至少有一軟性電路板 212 貼合於周邊區 230,用來傳輸各種控制訊號。閘極驅動晶片 208 藉由複數個輸出端 218 傳送訊號至掃描線 214,而資料驅動晶片 206 則藉由複數個輸出端 219 傳送訊號至資料線 216。其中,資料驅動晶片 206 及閘

極驅動晶片 208 接合至玻璃基板 204 時,可使用各種適合之接合材料,異方性導電膜 210 僅為其中之一。

間極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 係使用半導體晶片來製造,而在一般情況下,半導體晶片通常是堅硬且不易彎曲的。當半導體晶片所製造的間極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 覆晶構裝於玻璃基板 204 後,接合點從高溫冷卻至室溫,因為晶片206、208 與玻璃基板 204 熱膨脹係數不同及半導體晶片不易彎曲之特性,會造成玻璃基板 204 的翹曲。但是當半導體晶片的厚度低於一定程度時,其物理特性也會隨之變化,其可被彎曲的程度會隨之前加。本發明即利用降低間極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206之厚度的做法,來使間極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 具有可撓曲位。為使間極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 具有可撓曲位。為使間極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 具有可撓曲的特性,其晶片厚度在製作時必須小於 0.3 公釐,如此即可消除溫度變化時接合點的殘餘應力。

為驗證本發明改變閘極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 之厚度對於玻璃基板 204 翹曲情形的影響,本發明在不同的驅動晶片厚度條件下,進行一連串玻璃基板翹曲情形的實驗,其結果如圖七及圖八所示。由圖七及圖八之驗證結果可以發現,當驅動晶片的厚度逐漸降低時,玻璃基板的翹曲程度也會隨之改善。其中,

圖七為驅動晶片接合點間之玻璃基板翹曲量與驅動晶片厚度之關係圖,而圖八為驅動晶片接合點下方之玻璃基板翹曲量與驅動晶片厚度之關係圖。

在圖七與圖八中,本發明另採用一組使用捲帶自動接合(tape automated bonding, TAB) 構裝技術製造的液晶顯示模組來與本發明 之覆晶構裝技術作比較。捲帶自動接合構裝技術係將驅動晶片製 造於外部之軟性電路板上,其較佔空間也會增加液晶顯示模組整 體重量,但是使用捲帶自動接合構裝技術時,驅動晶片並未直接 接合於玻璃基板上,所以不會產生幕狀缺陷。如圖七以及圖八所 示,本發明測量覆晶構裝(COG)之六種驅動晶片厚度造成之玻璃基 板翹曲量,並且針對上述實驗數據做出一迴歸曲線以及迴歸方程 式。同時,現有捲帶自動接合構裝(TAB)於接合點之間以及接合點 下方造成之玻璃翹曲量分別為 0.4μ m 以及 1.0μ m。因此,根據圖 七以及圖八之迴歸曲線以及迴歸方程式,當驅動晶片厚度小於 300 μ m 時 , 覆 晶 構 裝 (COG) 於 接 合 點 之 間 造 成 之 玻 璃 基 板 翹 曲 量 會 接 近或小於 0.4 µm, 並且於接合點下方造成之玻璃基板翹曲量會接 近或小於 1.0 µ m。由圖七及圖八之驗證結果可以發現,當驅動晶 片的厚度降低至 0.3 公釐之後,玻璃基板的翹曲程度可以接近使 用捲帶自動接合構裝技術製造的液晶顯示模組。此驗證結果證實 將閘極驅動晶片 208 與資料驅動晶片 206 之厚度降低至 0.3 公釐

以下,可以有效改善玻璃基板 204 的翹曲程度,進而改善幕狀缺陷的情形。

相較於習知使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組,本發明之液晶顯示模組使用具有可撓曲性的閘極驅動晶片與資料驅動晶片,因此可有效改善幕狀缺陷的情形,減低不良品淘汰率。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。

【圖式簡單說明】

圖式之簡單說明

圖一為習知使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之示意圖。圖二為習知使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之剖面圖。

圖三為習知玻璃基板產生翹曲現象之示意圖。

圖四為習知液晶顯示模組產生幕狀缺陷之示意圖。

圖五為本發明使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之示意圖。

圖六為本發明使用覆晶構裝技術製造的液晶顯示模組之剖面圖。

圖七及圖八為液晶顯示模組之驅動晶片厚度與玻璃基板翹曲程度

間之關係示意圖。

圖式之符號說明

100 - 200	1	00	•	200				
-----------	---	----	---	-----	--	--	--	--

液晶顯示模組

102 \ 104 \ 202 \ 204

玻璃基板

106 \ 206

資料驅動晶片

108 - 208

閘極驅動晶片

110 - 210

異方性導電膜

112 - 212

軟性電路板

120 - 220

顯示區

130 - 230

周邊區

214

掃描線

216

資料線

218 - 219

輸出端

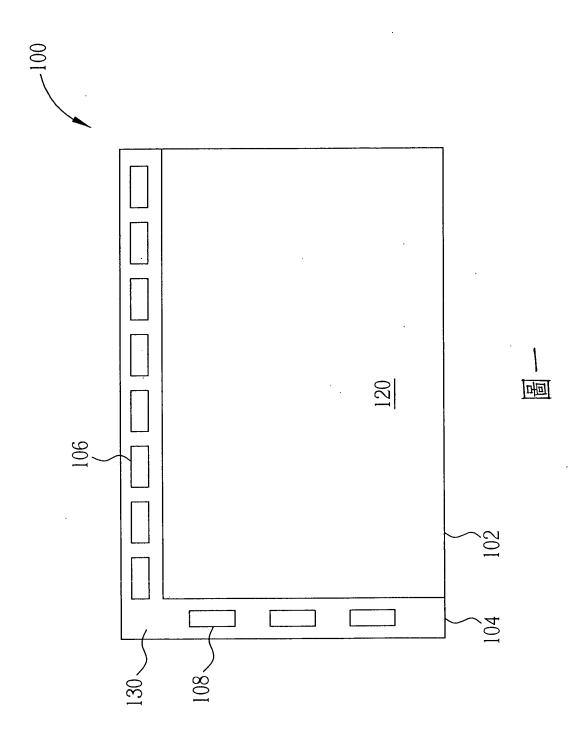
拾、申請專利範圍:

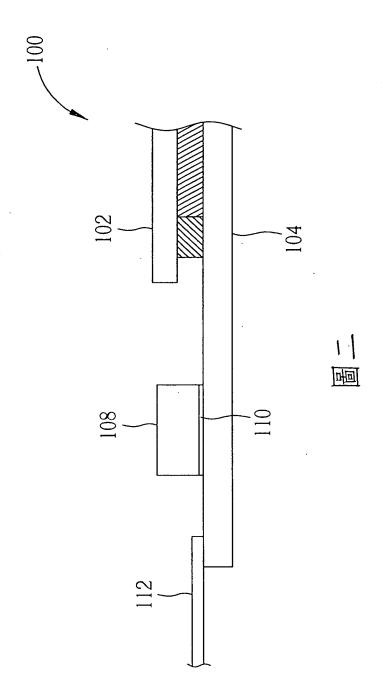
- 1. 一種液晶顯示模組,其包含有:
 - 至少一玻璃基板,該玻璃基板上具有一顯示區以及一周邊區, 複數條掃描線以及複數條資料線分別沿水平方向及垂直 方向設置於該顯示區上;
 - 至少一閘極驅動晶片,貼合於該周邊區上,該閘極驅動晶片藉 由複數個輸出端傳送訊號至該等掃描線,且該閘極驅動晶 片之厚度小於 0.3 公釐;以及
 - 至少一資料驅動晶片,貼合於該周邊區上,該資料驅動晶片藉 由複數個輸出端傳送訊號至該等資料線,且該資料驅動晶 片之厚度小於 0.3 公釐。
- 如申請專利範圍第1項之液晶顯示模組,其中該閘極驅動晶片 與該資料驅動晶片係以覆晶構裝方式,貼合於該玻璃基板上。
- 3. 如申請專利範圍第 1 項之液晶顯示模組,其中該閘極驅動晶片 與該資料驅動晶片係利用一接合材料貼合至該玻璃基板之該周邊 區上。
- 4. 如申請專利範圍第1項之液晶顯示模組,其中該接合材料係包

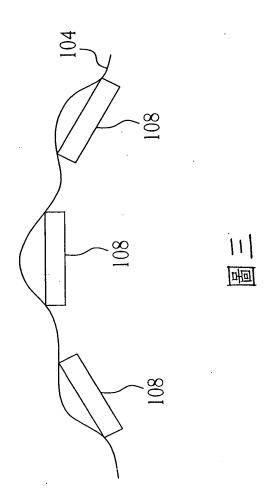
- 如申請專利範圍第1項之液晶顯示模組,其另包含有至少一軟性電路板貼合於該周邊區。
- 6. 一種液晶顯示模組,其包含有:
 - 至少一玻璃基板,該玻璃基板上具有一顯示區以及一周邊區, 複數條掃描線以及複數條資料線分別沿水平方向及垂直 方向設置於該顯示區上;
 - 至少一閘極驅動晶片,貼合於該周邊區上,該閘極驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至該等掃描線,且該閘極驅動晶片具有可撓曲性;以及
 - 至少一資料驅動晶片,貼合於該周邊區上,該資料驅動晶片藉由複數個輸出端傳送訊號至該等資料線,且該資料驅動晶片具有可撓曲性。
- 7. 如申請專利範圍第6項之液晶顯示模組,其中該閘極驅動晶片與該資料驅動晶片係以覆晶構裝方式,貼合於該玻璃基板上。
- 8. 如申請專利範圍第 6 項之液晶顯示模組,其中該閘極驅動晶片 之厚度小於 0.3 公釐。

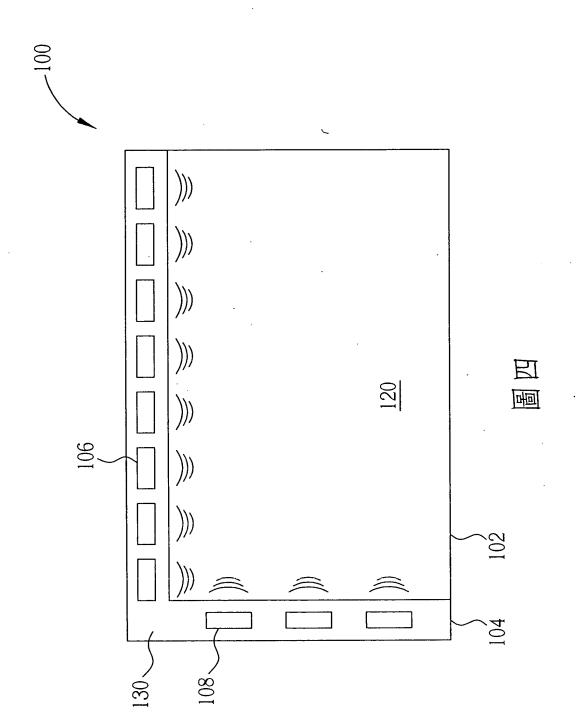
- 9. 如申請專利範圍第6項之液晶顯示模組,其中該資料驅動晶片之厚度小於0.3公釐。
- 10. 如申請專利範圍第6項之液晶顯示模組,其中該閘極驅動晶 片與該資料驅動晶片係利用一接合材料貼合至該玻璃基板之該周 邊區上。
- 11. 如申請專利範圍第10項之液晶顯示模組,其中該接合材料係包含一異方性導電膜。
- 12. 如申請專利範圍第6項之液晶顯示模組,其另包含有至少一軟性電路板貼合於該周邊區。

拾壹、圖式:

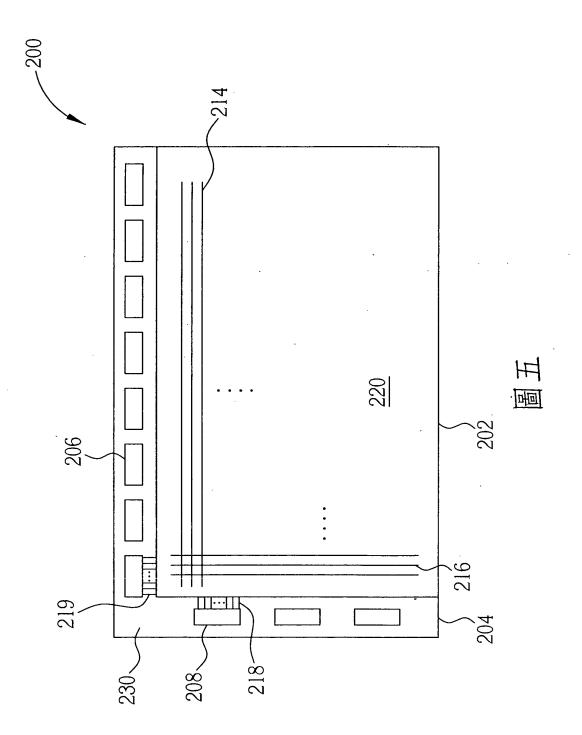


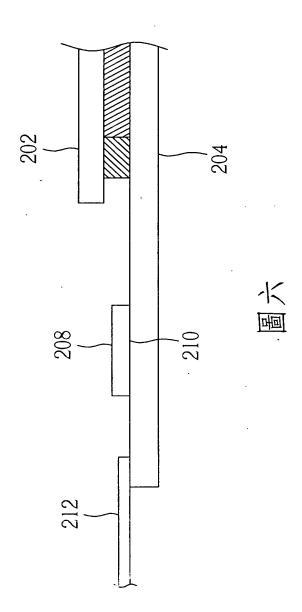






-





700 009 500 400 厚度(um) 圖十 300 y=0.0002x+0.3507 \triangleleft \triangleleft 200 4 100 TAB 0.2 0.8 9.0 0.4 0 無程度(um)

晶片厚度對翹曲程度關係圖

700 500 Q 009 500 TAB 晶片厚度對翹曲程度關係圖 400 $y=(8\times10^{-6})X^2+(6\times10^{-5})X+0.5309$ 厚度(um) 圏入 300 200 \Box 100 0 3.5 0.5 0.0 4.0 3.0 2.5 2.0 <u>.</u> (mu)휯 駐曲藤

1